

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-166

武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月16日、2024年9月2日召开第四届董事会第三十七次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为保证公司子公司苏州精材半导体科技有限公司（以下简称“苏州精材”）的正常生产经营，拓宽资金渠道，拟对苏州精材向银行申请授信提供最高担保额度人民币3,000万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-126）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：

二、担保进展情况

为满足子公司苏州精材日常经营发展需要，公司近日与苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行（以下简称“苏州银行”）签订编号为“苏银高保字[706610015-2024]第【508818】号”的《最高额保证合同》，约定公司为苏

州精材向苏州银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保合同的主要内容

(一)《最高额保证合同》(编号：苏银高保字[706610015-2024]第【508818】号)

1、债权人：苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：苏州精材半导体科技有限公司

4、保证额度有效期自2024年10月16日起至2027年10月16日止

5、保证最高本金限额为人民币：壹仟万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：包括主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等)。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。在本金余额不超过最高限额的前提下，因利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、财产处置费、过户费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出最高限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。

8、保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算，即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主

合同项下的债务提前到期或主合同解除的，则保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起三年。主合同项下债务分期履行的，每期债务的保证期间为自主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 90,685.00 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2023 年 12 月 31 日净资产的 24.47%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年11月14日